

請求の範囲

- [請求項1] 熱硬化性樹脂と、硬化剤と、エラストマーと、を含有し、
前記熱硬化性樹脂が脂環式環を有するエポキシ樹脂を含む、接着剤組成物。
- [請求項2] 前記硬化剤がフェノール樹脂を含む、請求項1に記載の接着剤組成物。
- [請求項3] 前記エラストマーがアクリル樹脂を含む、請求項1又は2に記載の接着剤組成物。
- [請求項4] 前記熱硬化性樹脂が脂環式環を有しない芳香族エポキシ樹脂をさらに含む、請求項1～3のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
- [請求項5] 前記脂環式環を有しない芳香族エポキシ樹脂が25℃で液体である、請求項4に記載の接着剤組成物。
- [請求項6] 無機フィラーをさらに含有する、請求項1～5のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
- [請求項7] 硬化促進剤をさらに含有する、請求項1～6のいずれか一項に記載の接着剤組成物。
- [請求項8] 請求項1～7のいずれか一項に記載の接着剤組成物をフィルム状に形成してなる、フィルム状接着剤。
- [請求項9] 基材と、
前記基材上に設けられた、請求項8に記載のフィルム状接着剤と、
を備える、接着シート。
- [請求項10] 前記基材がダイシングテープである、請求項9に記載の接着シート。
- [請求項11] 前記フィルム状接着剤の前記基材とは反対側の面に積層された保護フィルムをさらに備える、請求項9又は10に記載の接着シート。
- [請求項12] 基板上に第1のワイヤを介して第1の半導体素子を電気的に接続するワイヤボンディング工程と、
第2の半導体素子の片面に、請求項8に記載のフィルム状接着剤を

貼付するラミネート工程と、

前記フィルム状接着剤が貼付された第２の半導体素子を、前記フィルム状接着剤を介して圧着することで、前記第１のワイヤの少なくとも一部を前記フィルム状接着剤に埋め込むダイボンド工程と、
を備える、半導体装置の製造方法。